

Bielsko-Biała, 11.10.2018 r.

## **LS Tech-Homes S.A. zmienia nazwę na Module Technologies**

**LS Tech-Homes S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zmienia nazwę na Module Technologies S.A. Przeprowadzenie rebrandingu jest związane z ewolucją strategii rozwoju Spółki w kierunku generalnego wykonawstwa budownictwa modułowego 3D i 2D, z wykorzystaniem płyt drewnianych klejonych warstwowo w technologii BBS (CLT).**

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej zarejestrował w dniu 9 października zmianę nazwy Spółki z LS Tech-Homes S.A. na Module Technologies S.A. Dokonanie zmiany nazwy, wraz z nową identyfikacją wizualną, stanowi jeden z kluczowych elementów, niezbędnych do zakomunikowania nowego kierunku strategicznego rozwoju Emitenta. Głównym celem rebrandingu jest dążenie do wzmocnienia koncentracji działań Spółki w obszarze generalnego wykonawstwa, jak i podwykonawstwa, dla realizacji inwestycji budownictwa modułowego. Nowy kierunek rozwoju będzie oparty na dwóch zasadniczych filarach:

- Głównym obszarem aktywności biznesowej Module Technologies, będą nowe inwestycje wielkopowierzchniowe oparte o płytę BBS (CLT). Wartością dodaną oferowaną przez Module Technologies S.A. będzie wykorzystywanie technologii łączenia materiałów wykonanych z BBS (CLT) w gotowe moduły 3D (stanowiące finalny produkt użytkowy), w oparciu o know-how licencjonowany przez spółkę Module Investment Sp. z o.o.
- Drugi filar w strategii rozwoju Spółki stanowiła będzie kontynuacja realizacji mniejszych inwestycji, z użyciem paneli SIP oraz konstrukcji wykonanych w technologii pultruzji.

Zarząd Module Technologies S.A. jest przekonany, że obranie nowego kierunku strategicznego rozwoju Spółki, w połączeniu ze zmianą identyfikacji wizualnej, wpłyną korzystnie umacnianie jej pozycji rynkowej, a w konsekwencji na wyniki finansowe.

*„Zmiana marki z LS Tech-Homes na Module Technologies jest ukoronowaniem realizacji strategicznego rozwoju Spółki w kierunku wykonawstwa wielkopowierzchniowego, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii modułowej. Dzięki temu krokowi, stosowana dotychczas technologia SIP zostanie wsparta przez silne zaplecze technologiczne, otwierając tym samym przed budownictwem modułowym nowe perspektywy dla dalszej ekspansji na wymagające rynki zagraniczne. Zarząd Spółki podejmując decyzję o zmianach wizerunkowych, postawił również przed Spółką wysokie oczekiwania odnośnie organizacji pracy, w celu zwiększenia konkurencyjności oraz jakości realizowanych pod nową marką inwestycji.”* - podkreśla Mirosław Pasieka, Prezes Zarządu Spółki Module Technologies S.A.

Technologia BBS (CLT) posiada wiele zalet, do których można zaliczyć przede wszystkim jej wysoką izolacyjność termiczną oraz akustyczną. Jest ona również technologią, która umożliwia czyste, suche, proste i szybkie wznoszenie obiektów z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów budowlanych (2D) lub gotowych modułów (3D). Płyty BBS

(CLT) cechuje też znaczna pojemność cieplna oraz wilgotnościowa, wpływająca korzystnie na komfort użytkowania budynków, jak i prozdrowotny charakter wykonanych z nich pomieszczeń mieszkalnych. Technologia ta posiada również bardzo wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń zarówno w płaszczyźnie, jak i prostopadle do płaszczyzny płyty. Dzięki tym wszystkim właściwościom BBS (CLT) staje się istotnym konkurentem dla powszechnie używanych materiałów budowlanych. Zarząd Module Technologies S.A. uważa, że równoległy rozwój dwóch segmentów biznesowych tj. BBS (CLT) jak i SIP, przełoży się na uzyskanie korzystnego efektu synergii oraz wzrost wartości Spółki.

*„W stosunku do stosowanych dotychczas paneli SIP, nowe elementy budowlane wykonane w technologii BBS (CLT) znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie wielokondygnacyjnym, szczególnie jako alternatywa dla stalowych stropów, stropów betonowych czy ścian blokowych (również ognioodpornych). Pozwolą one również na obniżenie kosztów już we wstępnym etapie budowy, dzięki uzyskaniu gładkich powierzchni ścian, zmniejszając wyraźnie koszty ich wykończenia w stosunku do stosowanych powszechnie płyt gipsowych. Nie bez znaczenia są również doskonałe współczynniki akustyczne, termoizolacyjne czy zdrowotne elementów budowlanych wykonanych z użyciem BBS (CLT) - będzie to mieć szczególne znaczenie przy realizacji inwestycji takich jak np. budownictwo mieszkaniowe, hotelowe oraz użytkowe.”* - dodaje Prezes Pasieka.

Nowy etap w działalności Spółki został zainaugurowany podpisaniem w dniu 5 października br. Umowy z RIM Investment sp. z o.o. S.K.A. na zaprojektowanie i generalne wykonanie inwestycji "DuoVita Smart Apartments" w Wiśle. Elementami inwestycji będą budynki apartamentowe wraz z infrastrukturą komercyjną, przewidywana wartość jej wykonania przez Module Technologies S.A. wyniesie około 50 milionów złotych netto.

Dodatkowe zaplecze finansowania rozwoju Spółki na kolejne lata stanowiąc będą podpisane przez LS Tech-Homes S.A. 30 lipca br. oraz 27 września br. porozumienia (LOI) z niemieckimi inwestorami na generalne wykonawstwo dwóch projektów, o wartości odpowiednio: 42,4 milionów Euro oraz 45,5 milionów Euro. Obie inwestycje zostaną wykonane w technologii modułowej z użyciem płyty BBS (CLT).

Spółka zakończyła 2017 r. zyskiem netto w wysokości 1,05 mln zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 36,35 mln zł.

Module Technologies S.A. (poprzednio LS Tech-Homes S.A.) jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od czerwca 2012 r. zajmując się produkcją na rynek Europejski paneli kompozytowych w technologii SIP, które są wykorzystywane do budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz obiektów przemysłowych.

\*\*\*

Kontakt:

Artur Górski

Module Technologies S.A. (dawniej LS Tech-Homes S.A.) - Relacje Inwestorskie

[www.lstechhomes.com](http://www.lstechhomes.com)

[artur.gorski@lstechhomes.com](mailto:artur.gorski@lstechhomes.com)

tel. +48 501-215-243